



當前國際情勢下的台美經貿發展

行政院經貿談判辦公室

111.10.04

目錄

一、全球政治焦點

1-1 持續演變的紛爭

1-2 未來必須注意的事件

二、國際總體經濟的挑戰

2-1 通貨膨脹威脅尚存，多國持續升息

2-2 未來總體經濟預測

三、美國近期重要經貿政策

3-1 晶片法案 (CHIPS Act)

3-2 通膨削減法案 (Inflation Reduction Act)

3-3 百日供應鏈研究報告(100-day-supply-chain-review-report)

3-4 美國貿易政策的轉變動機與方向

四、台灣經貿的重要一步：台美21世紀貿易關係

1-1 持續演變的紛爭之一

烏俄戰爭?! 全球政經最難預測及最不穩定的變數!

- 俄舉辦四佔領地公投，澤連斯基宣布加入北約：
雙方互踩底線，短期情勢升溫。

觀察變數：核武賽局

- 上海合作組織峰會後的中俄關係變化：
習近平疫後出訪首站來到上海合作組織峰會，並與普丁見面。
但會後聲明，習隻字未提烏克蘭局勢及北約威脅，僅籠統地闡述
中國和俄羅斯的世界觀。(美國之音報導0930)

觀察變數：適可而止，戰爭趨緩 VS 恣意獨行，擴大戰事

- 烏俄戰爭情勢升溫，再度帶來原物料供應鏈危機：
俄羅斯出口占全球比例 -
天然氣(20%)、石油(10%)、鎳(49%)、鈮(42%)、鋁(26%)、氨(23%)、
鉀肥(17%)、尿素(14%)、磷酸鹽(10%)

(財經M平方報導2021)

觀察變數：歐洲寒冬經濟能否支撐



上合組織峰會，俄印中領袖見面



上合組織會議晚宴會談，普丁未被安排主要位置

圖: 攝自 Presidency of the Republic of Türkiye 推特

1-1 持續演變的紛爭之二

美中貿易及科技戰爭將持續進行：

● 科技戰上演軍備競賽：美國晶片法案 vs 中國芯片大基金

- 補貼→造成競爭惡化、晶片供需失衡
- 補貼競爭帶來→保護主義的抬頭

(註：國家集成電路產業投資基金股份有限公司)

● 美國制裁手段將更加嚴厲：

- 制裁中國企業名單近2年共增加 110多家公司，總數來到600多
- 在半導體部分，禁止EUV設備後，今年下半年一口氣擴大至軟體及原料
- 雷蒙多：「制裁清單短期內沒有鬆綁的可能」(路透社 0602)

● 晶片聯盟(CHIP4) 不只是圍堵：

- 美歐、美日、美韓、美台 都已先建立科技對話機制
- 聯盟若成立，供應鏈的移轉將加速進行
- 可觀察CHIP4是否成為「類OPEC」組織

● 懲罰性關稅仍將持續



中國設新公司躲制裁 美考慮擴大實體清單

路透社 中文新聞
2022年6月2日

(路透社華盛頓31日電)美國正在調查中國逃避美國制裁的行為，美國商務部長雷蒙多今天表示，拜登政府同時也正積極考慮，將更多中國企業加入美國政府的經濟黑名單中。

被美國商務部列入實體清單 (Entity List)，將無法自美國進口產品。

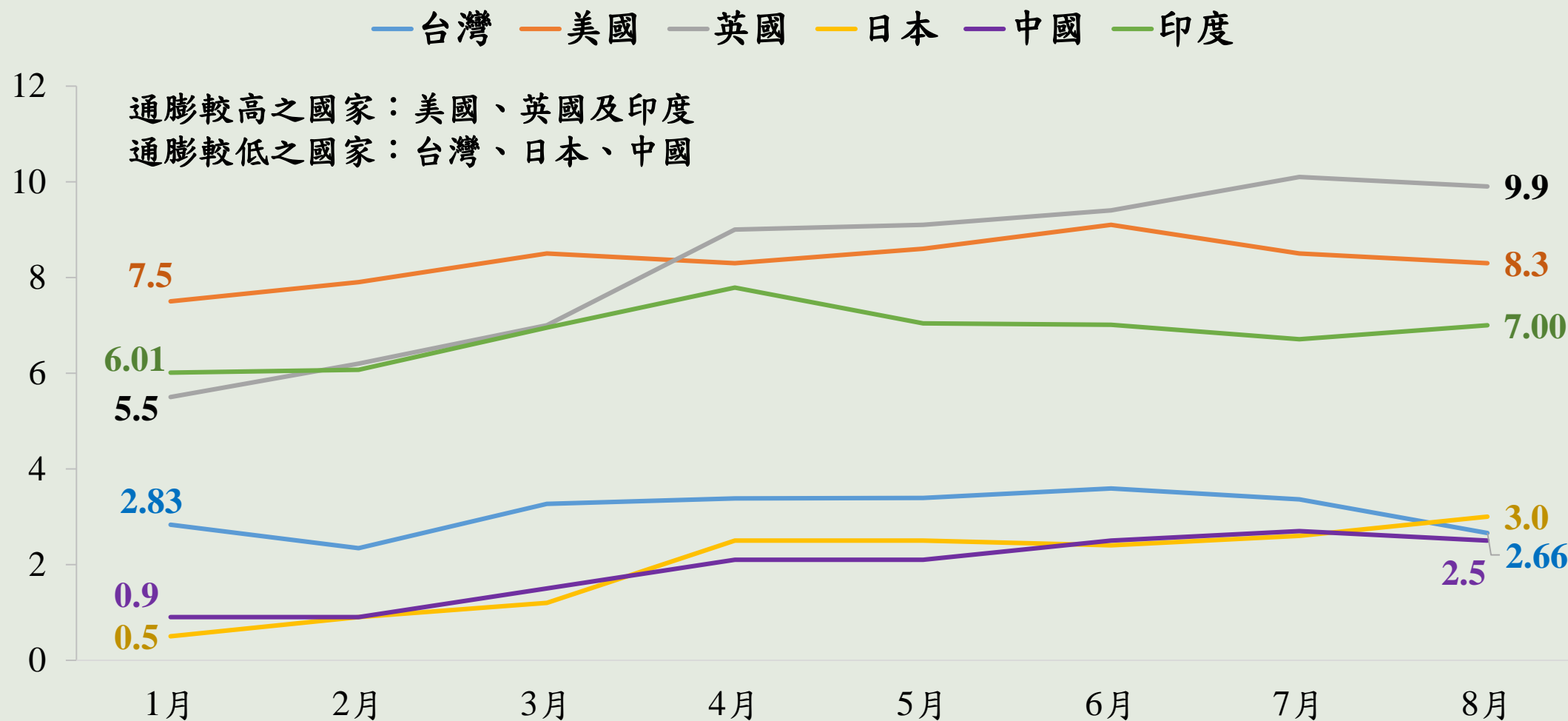
路透社報導，雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國政府正努力「取得中國有不當行為者的相關訊息，並將這些公司加到實體名單中...我們正進行多項調查」。

她補充說：「我不認為我們近期會放寬制裁。」

1-2 未來必須注意事件 !!

- 中國二十大，習近平可望連任：
 - 觀察其政治局常委及委員的佈局，可以知道其政權是否持續穩固
 - 注意過去「共同富裕」、「雙循環」、「清零封關」等經濟政策是否持續或更新
- 11/15 G20元首峰會，美中俄領導人可能首次齊聚：
 - 拜登的期中考剛落幕；習近平剛獲得史無前例的連任；普丁目前面臨多重外交困境
 - 全球政治局勢的是否能夠緩和？可關注三位領導人的交鋒對談
 - 緊接著APEC 領袖峰會將於 11/17登場，可觀察美中對全球經貿領域發展上的態度

2-1 2022年各主要國家通貨膨脹威脅尚存

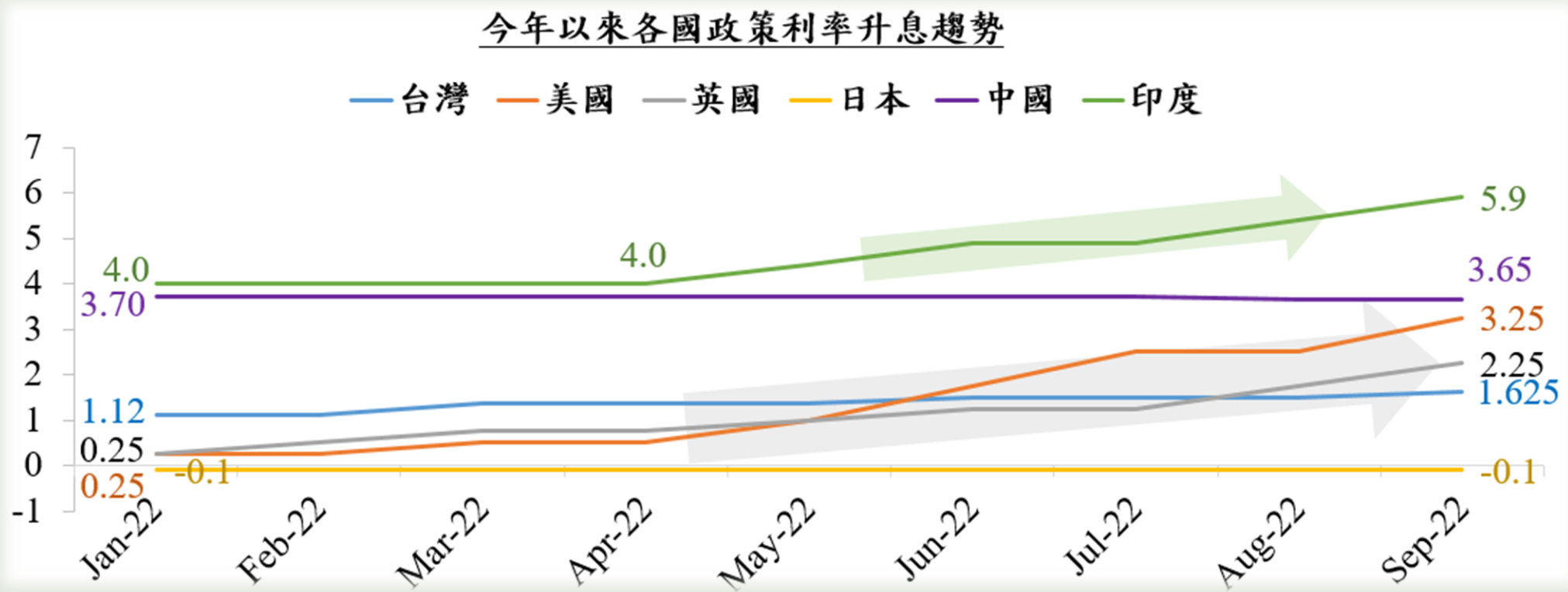


2-1 重要國家利率持續上升(中、日除外)

◆9月升息狀況

| 國別 | 政策利率 | 升息碼數 |
|----|--------|------------|
| 台灣 | 1.625% | +半碼(0.125) |
| 美國 | 3.25% | +3碼(0.75) |
| 英國 | 1.25% | +3碼(0.75) |

| 國別 | 政策利率 | 升息碼數 |
|----|--------|----------|
| 日本 | -0.10% | - |
| 中國 | 3.65% | -0.05 |
| 印度 | 5.9% | +2碼(0.5) |



2-2 未來總體經濟預測

因對戰爭、通膨、升息、需求趨緩等之擔憂，OECD多下調2022年、2023年各國經濟表現，且對2023年之表現更顯悲觀。

| | 2022 | | 2023 | | | 2022 | | 2023 | |
|-----------|------------|--------------|------|------------|-----------|------------|---------------|------|--------------|
| | 6月估 | 9月估 | 6月估 | 9月估 | | 6月估 | 9月估 | 6月估 | 9月估 |
| 全球 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | G20 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.2 |
| 澳洲 | 4.2 | 4.1 | 2.5 | 2.0 | 阿根廷 | 3.6 | 3.6 | 1.9 | 0.4 |
| 加拿大 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 1.5 | 巴西 | 0.6 | 2.5 ↑ | 1.2 | 0.8 |
| 歐元區 | 2.6 | 3.1 ↑ | 1.6 | 0.3 | 中國 | 4.4 | 3.2 | 4.9 | 4.7 |
| 德國 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | -0.7 | 印度 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 5.7 |
| 法國 | 2.4 | 2.6 ↑ | 1.4 | 0.6 | 印尼 | 4.7 | 5.0 ↑ | 4.7 | 4.8 ↑ |
| 義大利 | 2.5 | 3.4 ↑ | 1.2 | 0.4 | 墨西哥 | 1.9 | 2.1 ↑ | 2.1 | 1.5 |
| 西班牙 | 4.1 | 4.4 ↑ | 2.2 | 1.5 | 俄羅斯 | -10.0 | -5.5 ↑ | -4.1 | -4.5 |
| 日本 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 沙烏地阿拉伯 | 7.8 | 9.9 ↑ | 9.0 | 6.0 |
| 韓國 | 2.7 | 2.8 ↑ | 2.5 | 2.2 | 南非 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| 英國 | 3.6 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 土耳其 | 3.7 | 5.4 ↑ | 3.0 | 3.0 |
| 美國 | 2.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | | | | | |

資料來源：OECD Economic Outlook, Interim Report September 2022。

3-1 美國近期重要經貿政策：晶片法案 CHIPS Act

DIVISION A : CHIPS Act of 2022

| 半導體用途規劃 | 預算金額 (billion\$) |
|-------------|--------------------|
| 半導體發展 | 54.2 |
| - 製造回流 | - 37(高階) + 2(傳統28) |
| - R&D 人力發展 | - 13.2 |
| - 科技安全相關活動 | - 0.5 |
| - 網路通訊 ORAN | - 1.5 |

*投資稅務優惠(ITC)未列入預算，主要來自生產設備進口抵免，最高可達投資額的25%，預計有24B的效益。

AB總計約 280B

DIVISION B : Research and Development, Competition, and Innovation Act

| Key Programs | Five-Year Authorization | Increase over Baseline |
|--|-------------------------|------------------------|
| National Science Foundation (NSF) | \$81 billion | \$36 billion |
| • NSF Tech Directorate | \$20 billion | \$20 billion |
| • NSF Core Activities | \$61 billion | \$16 billion |
| Department of Commerce (DOC) | \$11 billion | \$11 billion |
| • Regional Technology Hubs | \$10 billion | \$10 billion |
| • RECOMPETE Pilot | \$1 billion | \$1 billion |
| National Institute of Standards and Technology (NIST) | \$10 billion | \$5 billion |
| • NIST Research | \$6.9 billion | \$2.8 billion |
| • Manufacturing USA | \$829 million | \$744 million |
| • Manufacturing Extension Partnership | \$2.3 billion | \$1.5 billion |
| Department of Energy (DOE)* | \$67.9 billion | \$30.5 billion |
| • DOE Office of Science | \$50.3 billion | \$12.9 billion |
| • Additional DOE Science and Innovation | \$17.6 billion | \$17.6 billion |
| Total | \$169.9 billion | \$82.5 billion |

*Across all the DOE sections, there is:

- A total of \$14.7 billion for infrastructure, equipment, and instrumentation across 17 DOE National Laboratories.
- A total of \$16.5 billion in new or above baseline authorizations for research in the 10 technology areas identified in USICA across the Office of Science and DOE's applied R&D offices in advanced energy and industrial efficiency technologies, artificial intelligence and machine learning, advanced manufacturing, cybersecurity, biotechnology, high performance computing, advanced materials, and quantum information science.

3-1 美國近期重要經貿政策：晶片法案 CHIPS Act

DIVISION A : CHIPS Act of 2022 Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors(CHIPS)



四大目標

- 在美國內建立並擴大先進半導體之生產
- 為關鍵產業建置充足且穩定之晶片技術
- 藉由投資研發半導體，強化美國在下世代關鍵製造技術及應用產業的領先地位
- 創造多元化勞動力，打造強韌的半導體產業參與體系



六大原則

- 保護納稅人權益，妥善運用資金
- 兼顧經濟與國家安全
- 確保長期在半導體領域的領先地位
- 催化私部門共同投資
- 強化且擴大區域製造及創新產業聚落
- 為廣大的關係人創造最佳利益

3-2 美國近期重要經貿政策：通膨削減法案 (Inflation Reduction Act)

收入

支出

減少赤字

TOPLINE ESTIMATES:

| | |
|---|-----------------------|
| TOTAL REVENUE RAISED | \$737 billion |
| <i>15% Corporate Minimum Tax</i> | <i>222 billion*</i> |
| <i>Prescription Drug Pricing Reform</i> | <i>265 billion***</i> |
| <i>IRS Tax Enforcement</i> | <i>124 billion**</i> |
| <i>1% Stock Buybacks Fee</i> | <i>74 billion*</i> |
| <i>Loss Limitation extension</i> | <i>52 billion*</i> |
| TOTAL INVESTMENTS | \$437 billion |
| <i>Energy Security and Climate Change</i> | <i>369 billion*</i> |
| <i>Affordable Care Act Extension</i> | <i>64 billion**</i> |
| <i>Western Drought Resiliency</i> | <i>4 billion***</i> |
| TOTAL DEFICIT REDUCTION | \$300+ billion |

* = Joint Committee on Taxation estimate

** = Congressional Budget Office estimate

*** = Senate estimate, awaiting final CBO score

3-2 美國近期重要經貿政策：通膨削減法案 (Inflation Reduction Act)



歐盟、韓國受到的衝擊

共同點

- 當前電動車電池之關鍵礦物、組件，尚未於美國建立起供應鏈，故短期難有電動車符合IRA法案之稅額扣抵標準

歐盟

- 此法案規定適用的汽車售價，箱型車、休旅車、皮卡車等不得超過80,000美金
- 其他車型不得超過55,000美金，惟歐規車如部分BMW價位易高於此規定(此節部分Tesla車型亦受影響)
- 另Porsche保時捷亦將受在美組裝之條件影響，不適用此優惠措施

韓國

- 受在美組裝之條件影響，不適用此優惠措施者，包括Hyundai現代汽車、Kia起亞汽車、Toyota豐田汽車(日本)

3-3 美國近期重要經貿政策：百日供應鏈報告

(100-day-supply-chain-review-report)

半導體

- 美沒有先進製程產能
- 高度仰賴亞洲
- 中國竊取智財權
- 要減少地緣政治風險
- 避免中國掌控供應鏈

關鍵礦物

- 與乾淨能源發展有高度相關
- 美國生產成本太高，以至於高度仰賴中國
- 中國精煉技術相當好，占有極高的供應鏈占比和價值。

電池

- 現階段乾淨能源重要工業產品
- 美國在先進、大容量電池的製造遠遠落後
- 中國車用電池產能占全球40%以上

藥品

- 過度仰賴國外業者
- 缺乏備援製造能量
- 及時存貨應急能力差
- 製造商過度集中
- 學名藥市場遭不公平貿易破壞



已有晶片法案、制裁清單等手段



已有削減通膨法案等補貼手段

3-4 美國貿易政策的轉變動機與方向

IPEF

~四大支柱~

1. 貿易 - 農業、透明化、貿易便捷、公平競爭、包容性、技術合作
2. 供應鏈 - 增加關鍵商品的韌性和投資、擬定關鍵商品的標準、建立資訊共享及風險預警機制、強化運輸效率、強化勞工地位、改善供應鏈透明化機制
3. 潔淨能源 - 推動潔淨能源技術合作、共同削減溫室氣體、增進綠色經濟發展、保護海洋、禁止野生動物販運、非法砍伐、加強生物多樣性。
4. 公平經濟 - 反貪腐、遏止逃稅、為企業和工人提供公平的環境、提高透明度。

和台美21世紀貿易倡議能高度接軌

美國貿易政策的方向：

- 關稅不是未來的首要討論選項
- 發展WTO、APEC 無法聚焦的下世代題目
- 注重競爭市場的各项透明化機制
- 嘗試建立綠色經貿政策和價值體系

目標：重新塑造以規則為基礎的全球貿易



**美國國內兩黨都有高度共識，
不會輕易改變目標!!**

四、台灣經貿的重要一步：台美21世紀貿易關係



- 這些議題在CPTPP及USMCA均有類似規範，將有助我國爭取加入區域經貿組織。
- 未來雙方可視需要經由協商增列新議題

貿易便捷化
Trade facilitation

良好法制作業
Good regulatory practices

反貪腐
Anti-corruption

中小企業
SMEs

農業
Agriculture

標準
Standards

數位貿易
Digital trade

勞動
Labor

環境
Environment

國營事業
State-owned
Enterprises

非市場政策及做法
Non-market policies
and practices



希望達成之總體效益(1/2)



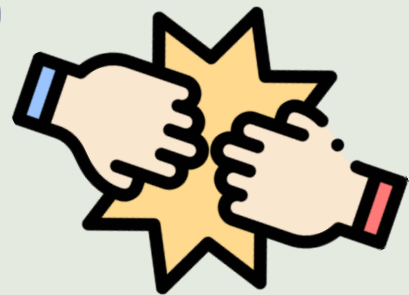
1 強化台美經貿關係

透過簽署協定，可以加速雙方法規制度調和，深化臺美經貿關係，促進雙方的貿易和投資。未來美國國會若授權行政部門進行關稅減讓及市場准入談判，則21世紀貿易倡議相關協定有很大機率進一步提升為「臺美FTA」。

2 強化台灣競爭力

透過高標準協定的執行，可以提升臺灣在新世代經濟的競爭力，增加國際投資人對臺灣經濟的信心，進而可吸引更多的全球的資金和高階技術。

希望達成之總體效益(2/2)



3 強化與各國制度化連結

臺美貿易協定的簽署，也將進一步提升臺灣經濟的層次，並體現對環境保護及勞工權益的重視，此不僅有助於我推動加入區域經濟組織如CPTPP，擴展國際空間，也可讓臺灣有更多機會與各國加深制度化連結。

4 強化市場經濟體制

臺美經濟的深化合作，亦可強化市場經濟體制，並透過共同合作來對抗可能來自第三方的經濟脅迫。

附件-美國半導體管制清單(2022年)

表一、美國半導體管制清單(2022年)

| | 項目 | 對中國進行出口管制 | 對中國管制相關技術資料 |
|-----------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 半導體設備 | 晶圓生成設備 | -- | -- |
| | 晶圓表面處理 | YES | YES |
| | 離子植入製程 | YES (高技術部份管制) | YES |
| | 化學機械研磨(CMP) | -- | -- |
| | 薄膜沉積 | YES (高技術部份管制) | YES |
| | 曝光機* | YES (EUV產品) | YES |
| | 微影壓印機 | YES | YES |
| | 電離子束微影機 | YES | YES |
| | 蝕刻設備 | -- | -- |
| | 製程控制設備 | -- | -- |
| | 晶片測試 | YES(射頻和分離式晶片) | -- |
| | 晶片封裝 | -- | -- |
| | 軟體 | 半導體設備軟體 | YES |
| IC設計EDA軟體 | | YES (2022.07) 3奈米以下設計 | YES |
| 晶片 | CPU | -- | YES |
| | GPU | YES (2022.08) 特定型號產品 | Unclear |
| | FPGA邏輯閘陣列 | YES | YES |
| | AI ASIC 特殊IC | Unclear | Unclear |
| 製造物料 | 晶圓原物料 | YES (先進製程) | YES |
| | 長晶棒 | YES (部份三五族) | YES |
| | 光罩 | YES (EUV和FPGA用) | YES |
| | 光阻 | YES (15nm以下用) | YES |
| | 蝕刻氣體 | YES | YES |
| | 摻雜劑 | YES | YES |
| | 氧化鎵、金剛石(第四類化合物) | YES (2022.08) | -- |



說明如上

行政院經貿談判辦公室
111.10.04